2007年5月25日

金線事業統合に関する基本合意について

当社は、田中貴金属工業株式会社及び同社子会社である田中電子工業株式会社と、平成19年秋を目処に国内及び海外の半導体ボンディング用金線事業（以下、「金線事業」という）について統合することで、本日、基本合意いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 事業統合の目的

当社は、昨年、中国における金線事業子会社であるMMCエレクトロニクス杭州社（中国名：杭州菱慶高新材料有限公司、所在地：中国浙江省杭州市）について、当社持分の一部を、田中電子工業株式会社及び田中貴金属インターナショナル株式会社（ともに田中貴金属工業株式会社の子会社）に譲渡した上で合弁会社とし、中国における金線事業の製造・販売の田中貴金属工業グループとの一体化を進め、同社の運営効率化及び事業拡大を図ってまいりました。

今後もグローバルな成長が期待される金線事業の競争力強化を図るため、今般、当社及び田中貴金属工業グループの金線事業を全面的に統合することで基本合意に達しました。これにより、両グループの技術面の融合、国内外の製造・開発・技術サポート拠点の集約及び全世界における販売窓口の一本化など、一層の効率化を図ってまいります。

2. 統合の時期および方法

平成19年秋を目処に、当社の金線事業を吸収分割の方法により田中電子工業株式会社に承継させることを基本とし、今後、両社協議の上、詳細条件を決定いたします。

3. ご参考

＜田中貴金属工業株式会社の概要＞

本社所在地　：東京都千代田区丸ノ内2－7－3
代　表　者　：代表取締役社長　岡本　英彌
設　　立　：1918年
資　本　金　：500百万円
主な事業内容　：工業用の貴金属製品の製造・販売及び金・プラチナなどの貴金属のディーリングによる貴金属地金の販売

＜田中電子工業株式会社の概要＞

本社所在地　：東京都千代田区丸ノ内2－7－3
代　表　者　：代表取締役社長　福井　康夫
設　　立　：1961年
資　本　金　：1,880百万円（田中貴金属工業株式会社の100%子会社）
主な事業内容　：半導体ボンディング材料の製造及び販売

以 上